

## アプリケーションカタログ

# 王水溶解した試料中の銅イオン(Cu<sup>2+</sup>)の定量

関連業界	:	-
使用装置	:	電位差自動滴定装置
測定手法	:	電位差滴定法/沈澱滴定
関連規格	:	-

### 1. 概要

電位差自動滴定装置を用いて、不純物を含んだ王水中の銅イオン(Cu<sup>2+</sup>)の定量を行った結果、良好な繰返し性を示した。銅イオン(Cu<sup>2+</sup>)の定量で不純物の妨害を防ぐ為に、強酸性の試料をアンモニア水で中和して酸性フッ化アンモニウムでマスクングを行った。

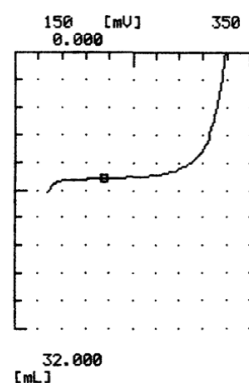
### 2. 装置構成

本体	:	電位差自動滴定装置 (標準プリアンプリファイア: STD)
電極	:	複合白金電極

### 3. 試薬

滴定液	:	0.1mol/L-チオ硫酸ナトリウム溶液
溶媒	:	蒸留水
添加試薬	:	28%アンモニア水、酸性フッ化アンモニウム 20%よう化カリウム溶液

### 4. 測定例



—滴定曲線—

—測定結果—

	Sample (mL)	titer (mL)	Cu <sup>2+</sup> Conc. (g/L)
1	10.0	14.7337	9.4195
2	10.0	14.7805	9.4494
3	10.0	14.6356	9.3568
平均			9.4085
偏差			0.0472
RSD (%)			0.50

詳細は、下記までお気軽にお問い合わせください。

<問い合わせ先> 京都電子工業株式会社

<http://www.kyoto-kem.com/ja/contact/form.php>